

マルチプレス ZENFormer nano 5t 機を用いた 極薄 2 層フィルムのハーフカット事例のご紹介！！



【狙いどころ】

- 1、nano機のスライド平行制御により、異形状・多数個取への対応を実現
- 2、nano機の高精度な下死点制御により、薄板セパレータへの対応を実現
- 3、高精度刃物との組み合わせで、2次仕上げ工程を削減しコストダウンを実現

【装置の特徴】

- 1、μレベルの下死点により多層フィルムの必要部分だけをジャストカット
- 2、4軸でのスライド平行制御により、刃当たり調整時間を大幅に削減。
- 3、成形中のスライド挙動が数値(グラフ)でモニタリング可能 ※IoT時代に対応
- 4、スライドモーションが任意で設定可能であり、細やかな成形動作を実現

【協賛共同開発企業】

株式会社ファインテック

HSK 座間事業所で 試し加工・データ取り 対応いたします。

【ハーフカット加工の特徴】

極薄セパレータフィルム素材でも安定加工

一般のプレス機
下死点バラツキ大

ZENFormer nano
下死点バラツキ小

下死点のバラつきをセパレータ厚さでカバー

材料費の削減が可能

多層フィルムを任意の位置までハーフカット

タッチパネルイメージ
タッチパネルで簡単設定
(最小設定単位は1 μ m)

下死点設定値 5.305mm
下死点設定値 5.285mm
下死点設定値 5.270mm

フィルム背面の刃先保護材が不要 \Rightarrow 高精度ハーフカットが可能

一般のプレス機
下死点バラツキ大

ZENFormer nano
下死点バラツキ小

高精度平面研磨 金属金型

高精度に加工された金属金型をそのまま型に使用可能

保護材が精度低下を招く可能性有り

多層フィルムの必要部分だけをジャストカット

一般のプレス機
下死点バラツキを考慮し刃先を深く入れる

ZENFormer nano
フィルム層のみをジャストカット

製品品質の向上が可能

【切断品質改善例】

改善前

改善後

【お問合せ先】 弊社HPまで御連絡下さい。URL : [http:// www.hsk.co.jp](http://www.hsk.co.jp)
 株式会社 放電精密加工研究所 開発事業部 (担当) 高橋、津山、原 まで!!
 〒252-0002 神奈川県座間市小松原1丁目39番地32号
 Tel : 046-240-1922 Fax : 046-240-1925